

Presse À Chaud Sous Vide Automatique De 15 Tonnes Avec Plateaux Chauffants 200X200Mm Et Refroidissement À Eau

Numéro d'article: XP33



Introduction

Découvrez la presse à chaud sous vide automatique de 15 tonnes de KINTEK : plateaux chauffants 200x200mm (jusqu'à 500°C), contrôle PID précis, refroidissement à eau et chambre en SUS 304 pour le traitement sous vide ou sous gaz inerte—idéale pour les cellules de batterie en pochet, la stratification de polymères et le soudage par diffusion.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Stratification de cellules de batterie en pochet	La stratification des cellules en pochet pour les batteries lithium-ion ou à l'état solide nécessite une pression et une chaleur uniformes pour lier les couches sans endommager l'électrolyte. La capacité sous vide élimine l'humidité et les gaz, empêchant la délamination et améliorant la longévité de la cellule.	Élimine la délamination, améliore la conductivité ionique et prolonge la durée de vie en cycles.
Stratification de films polymères	Stratifier des feuilles de polymère ou des films composites pour l'encapsulation électronique, l'emballage médical ou les écrans flexibles sous température et pression contrôlées.	Produit des liaisons sans bulles et à haute clarté avec un contrôle précis de l'épaisseur.
Soudage par diffusion	Assembler des métaux, alliages ou céramiques à des températures élevées sous vide élevé sans fusion, créant des liaisons par diffusion atomique.	Permet d'obtenir des interfaces à haute résistance, sans pores, idéales pour les échangeurs de chaleur et les dispositifs microfluidiques.
Compaction et frittage de poudres	Compresser des poudres métalliques ou céramiques dans une matrice sous vide et chaleur pour former des pastilles ou des préformes denses.	Augmente la densité, réduit la porosité et améliore les propriétés mécaniques et électriques.
Cuisson de matériaux composites	Cuire des composites renforcés de fibres avancés avec des profils de pression et de température précis dans une atmosphère inerte.	Optimise la réticulation, prévient l'oxydation et assure des stratifiés sans vides.
Assemblage d'électronique flexible	Stratifier et encapsuler des circuits flexibles, des écrans OLED ou des capteurs à couches minces avec des adhésifs activés par la chaleur sous vide.	Maintient l'alignement, élimine les défauts de dégazage et protège les composants sensibles.

Spécification	Valeur / Détails
Modèle	XP33
Pression de travail maximale	≤ 15 Tonnes (150 kN)
Température de travail des plateaux	Température ambiante - 500 °C, écran tactile PID programmable
Puissance de chauffe	3000 W
Dimensions des plateaux	200 mm × 200 mm
Ouverture des plateaux (Lumière)	50 mm
Pompe à vide incluse	Pompe à vide à palettes rotatives (standard)
Niveau de vide (Relatif)	< -0,1 MPa
Matériau de la chambre	Acier inoxydable SUS 304

Spécification	Valeur / Détails
Compatibilité des gaz atmosphériques	Azote (N ₂) / Argon (Ar)
Méthode de refroidissement	Refroidissement à eau en circulation (les deux plateaux)
Dimensions externes	650 × 492 × 725 mm
Poids net	235 kg
Alimentation électrique	AC 220V / 50Hz, Monophasé